

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-045

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于近日收到招标单位世源科技工程有限公司发来的《中标通知书》（编号：EE01-SYS-004-LOI），确认亚翔集成成为杭州富芯12英寸模拟集成电路芯片生产线项目（一期）洁净工程（包号为：EE01-SYS-004）的中标单位。现将相关情况公告如下：

### 一、业主信息

杭州富芯半导体有限公司成立于2019年，主要从事高性能模拟芯片的生产制造。富芯项目总投资金额400亿元，座落于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区，总占地约700亩，分两期建成。

富芯项目是浙江省超大型产业重点项目，也是浙江省首条12吋晶圆生产线。

项目一期投资金额180亿元，建设全球领先的12吋高性能模拟芯片生产线，规划产能5万片/月，达产后将是国内汽车电子、5G通信、云计算、人工智能等领域重要的高性能模拟芯片生产基地。

## 二、中标项目概况

- 1、项目名称：杭州富芯12英寸模拟集成电路芯片生产线项目（一期）洁净工程
- 2、项目地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇
- 3、招标人：世源科技工程有限公司
- 4、建设单位：杭州富芯半导体有限公司
- 5、中标金额：227,500,000.00元（大写：贰亿贰仟柒佰伍拾万圆整）（含税）
- 5、工程期限：计划工期为2021年11月1日-2022年5月25日
- 6、工程概况：本项目主要由建筑、暖通、给排水、电照、通信信息、自控、空间管理专业组成。本项目工作范围不仅包括主生产厂房1（车间区FAB1/生产设施区OB1）具有洁净级别的洁净室，还包括划入本项目范围内的非洁净室（区）如更衣室、连廊更鞋区、IT机房、冷库等。

## 三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。

## 四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年10月25日